

【閎康產學合作計畫】112 年徵件，5/4 起開放申請 閎康提供高階分析儀器服務

為提升新元件與新材料在研發過程中的分析檢測品質，促進產業升級，自民國 110 年始至 114 年止，閎康科技每年投入新台幣 2000 萬元整，預計每年補助 20 件專案，徵求以**開發高科技產品和製造、封裝、測試與系統**等主題，運用先進分析檢測技術的研究計畫，支持學術單位在創新元件、材料及創新構想的先期研究及開發。每年執行期間為當年度 8/1 開始至次年 7/31 止。

閎康科技邀請參與相關領域研究的優秀學者，由閎康提供高階分析儀器服務，結合學界的研究資源，合作推動基礎及應用研究，一起共創產學雙贏。

112 年度計畫時程

- 徵件時間：自 112 年 5 月 4 日起開始收件，至 112 年 6 月 15 日 截止受理。
- 結果公告：於 112 年 7 月 15 日 前將遴選結果通知服務中心與申請人。
- 計畫執行時間：自 112 年 8 月 1 日起 至 113 年 7 月 31 日止。

徵件對象

以國科會「基礎研究核心設施服務中心」為合作平台，其包含 **臺灣大學**、臺灣師範大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、中興大學、成功大學、中山大學 等八校。計畫主持人需具備國科會專題研究計畫主持人資格，並任職於受理服務中心所在機構，每人每年以申請一件為限。

遴選重點

- 研究主題以**量子電腦、化合物半導體、先進製程、光電材料、製造封裝**等相關領域優先。
- 具創新或未來應用發展潛力。
- 計畫之執行需使用閎康科技所提供之分析儀器。

補助項目由閎康科技提供下列尖端分析測試服務。依儀器設備分為 9 大領域：

1. 非破壞性結構觀察 (3D X-ray, SAT, Thermal EMMI)
2. 微結構與成份分析 (樣品製備, 高解析 TEM, SEM, FIB, EDS, EBSD, EELS, NBD, SAD)
3. 雜質濃度檢測 (SIMS, SRP, SCM, XPS, Auger)
4. 污染與微量檢測 (TOF-SIMS, XPS, FTIR, XRF)
5. 液態 TEM 分析 (K-kit)
6. 元件級電性量測與缺陷定位 (C-AFM, Nano-probing, EBIC/EBAC, PEM, OBIRCH, Thermal EMMI)
7. ESD (HBM, MM, CDM, Latch-up, TLP, EOS)
8. 可靠度測試 (HTOL, HAST, TCT, BLT, TS, Vibration, Shock, H2S corrosion, AMR/AMI, HRTB 等)
9. 物理化學分析 (ICP-MS, TGA, LC-MS 等)

經費補助

閎康產學合作計畫主要希望提昇研發過程中的分析檢測品質，因此整體的預算佔比將依下述方式安排：(此部分僅為建議做參考，申請人可自行估算比例，由審查專員會進行最後評核)

- 70%需屬閎康檢測費 (需逐次繳回)
- 20%校管理費
- 10%耗材雜支人事等業務費(建議使用現有的人力，以減少費用的支出)

簽約

依各校產學計畫相關規定辦理。

本校請洽研發處產學服務組個學院負責人(02)3366-6625。

申請方式

計畫主持人須具備科技部專題研究計畫主持人資格，並任職於八校服務中心所在機構，每人以申請一件為限。請依下列產學計畫申請書格式製作文件，於期限內將電子檔郵寄閎康科技行政窗口。逾期、文件不全或不符合規定者，不予受理。

聯絡人

閎康行政聯絡窗口 - 雷秀玲小姐 (03)611-6678 ext: 4322, JDP@ma-tek.com

閎康技術諮詢窗口 - 陳弘仁先生 (03)611-6678 ext: 3250, JDP@ma-tek.com

詳請至閎康科技網頁詳閱公告與 QA

https://www.matek.com/zh-TW/News_Release/detail/IAR/all/20220504

[計畫說明下載點我](#)

[申請書下載點我](#)